

【3. 定格 RATINGS】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAX.)	40V	
最大許容電流 Rated Current (MAX.)	0.3 A / PIN *4	
使用温度範囲 *1 Operating Temperature Range	-40°C ~ +125°C *2	
保管条件 *3 Storage Condition	温度 Temperature	-10°C ~ +50°C
	湿度 Humidity	85% R.H.以下 (但し結露しないこと) 85% R.H. MAX. (No Condensation)
	期間 Terms	出荷後 6ヶ月 (未開封の場合) For 6 months after shipping (unopened package)

- *1 : 基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.
- *2 : 通電による温度上昇分を含む。
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.
- *3 : 保管環境は、塵埃の多い所、腐食性ガスが発生する場所及び結露は避けること。
Storage area is to be free of dust, corrosive gases and dew formation.
- *4 : 最大許容電流0.3Aでの使用は最大50極までとする。
但し、50極以上の総電流は各極を合計し、15A以下で使用すること。
0.3A MAX./PIN is to applied to 50pins MAX.
A total of 15A MAX. is to be applied to over 50 pins.

【4. 性能 PERFORMANCE】

標準状態 ; 特に指定がない限り、測定は以下の条件にて行う。
但し判定に疑義を生じた場合は、測定は以下の条件にて行う。

Standard atmospheric conditions;
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for conducting measurements and tests are as follows.

- 気温 Ambient temperature : 15°C to 35°C
- 湿度 Relative humidity : 25% to 85%
- 気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

If there is any doubt on the results, the measurement shall be conducted with the following test conditions.

- 気温 Ambient temperature : 20±1°C
- 湿度 Relative humidity : 63% to 67%
- 気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

A	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION		
	SEE SHEET 1 OF 14				
REV.	DESCRIPTION		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 2 OF 14

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA 以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX. (JIS C5402 5.4)	80 milliohm MAX.
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間に、DC 250V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 250V DC between adjacent terminal. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 Megohm MIN.
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間に、AC(rms) 250V (実効値) を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 250V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 25±3mm の速さで挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors at the speed rate of 25+/-3mm/minute.	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	保持力 Terminal / Housing Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引っ張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25+/-3mm/minute on the terminal pin or nail Assembled in the housing.	0.2N { 0.02kgf } MIN.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.4MM PITCH FLOATING BB CONN
PRODUCT SPECIFICATION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
2039550000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
3 OF 14

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 10回以下 の速さで挿入、 抜去を 30回 繰返す。 When mated up to 30 cycles repeatedly by the rate of 10 cycles per minute.	接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を 通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate connectors, measure the temperature rise of contact when the maximum current is passed. (UL 498)	温 度 上 昇 Temperature Rise	30 °C MAX.
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、 嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向 に 掃引割合10~55~10 Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. Amplitude : 1.5mm P-P Frequency : 10-55-10Hz (MIL-STD-202 Method 201)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsec. MAX.
4-3-4	耐 衝 撃 性 Shock	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、 嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に 490m/s ² { 50G }、衝撃作用時間11ms の衝撃 を 各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法213) Mate connectors, add to each 3 times with impact of 490m/s ² {50G}and shock pluses for a duration of 11ms at 6 directions mutually vertical including fitting axis in DC 1 mA electricity state. (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
			瞬 断 Discontinuity	1.0 microsec. MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.4MM PITCH FLOATING BB CONN
PRODUCT SPECIFICATION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC
TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
2039550000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
4 OF 14

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、125±2°C の雰囲気中に96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors, exposing for 96 hours in the atmosphere of 125+/-2 degree C. After the test, allowed to stand at room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate connectors, exposing -40+/-3 degree C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)	外観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2°C、 相対湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors, exposing for 96 hours in an atmosphere of 60+/-2 degree C, relative humidity 90 to 95%. After the test, allowed to stand at room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接触抵抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	50 Megohm MIN.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.4MM PITCH FLOATING BB CONN
PRODUCT SPECIFICATION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
2039550000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
5 OF 14

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55°C に 30分、+125°C に 30分 これを 1サイクル とし、5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後 1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-14) Mate connectors, exposing to 125+/-2 degree C and -55+/-3 degree C temperature extremes for 30 minutes each including a 0-5 minutes transition time. The above-mentioned condition is repeated 5 cycles. After the test, allowed to stand at the room temperature for 1 to 2 hours before checking functionality. (JIS C60068-2-14)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
4-3-9	塩 水 噴 霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2°C にて 5±1% 重量比 の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法 101) Mate connectors, exposing to the atmosphere where salt mist is diffused in. Other condition is written below. NaCl solution : 5+/-1% by weight Temperature : 35+/-2 degree C Duration : 48+/-4 hours After the test, they should be washed well by water and dried at room temperature before checking functionality. (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	実装したコネクタを嵌合させ、40±2° C にて 50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間放置する。 Mate mounted connectors, exposing to the atmosphere is written below. Gas Concentration : SO ₂ =50±5ppm Temperature : 40±2° C Duration : 24 hours	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	100 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 14

TITLE:

0.4MM PITCH FLOATING BB CONN
PRODUCT SPECIFICATION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER
2039550000

DOC. TYPE
PS

DOC. PART
000

CUSTOMER
GENERAL

SHEET
6 OF 14

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-11	半田付け性 Solderability	ターミナルまたはネイルをフラックスに浸し、 245±5°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Soldering Time: 3+/-0.5 sec. Solder Temperature : 245+/-5°C	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes.
4-3-12	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	リフロー時 第7項の条件にて、2回リフローを行う。 When reflowing Expose the specimen to infrared reflow condition. the test item paragraph 7, two times	外 観 Appearance	製品機能を損なう 異状なきこと No Damage on function
		手半田時 <u>Soldering iron method</u> 端子および金具の半田付け部を 350±10°Cの半田ゴテにて 最大5秒加熱する。 Apply soldering iron heated to 350±10°C to the soldering tail of terminal or nail for a maximum of 5 seconds.		

() : 参考規格 Reference Standard
{ } : 参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 7 OF 14

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS 】

図面参照 Refer to the drawing.

ELV 及び RoHS適合品 ELV AND RoHS COMPLIANT.

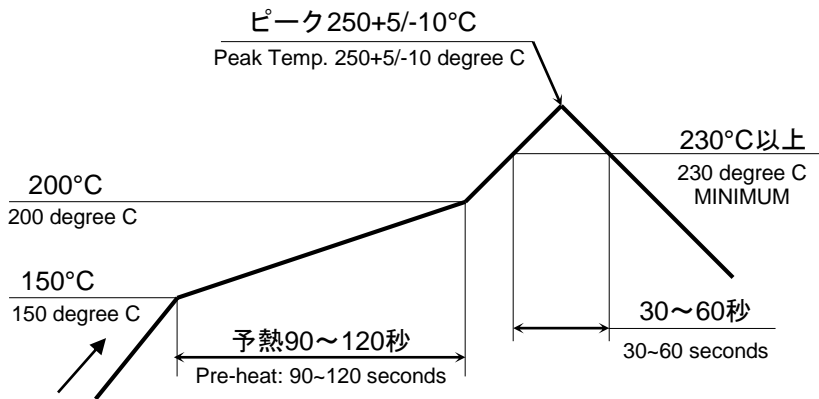
【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION/WITHDRAWAL FORCE 】

極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力(最大値) Insertion (MAX.)			抜去力(最小値) Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	6回目 6th	30回目 30th	初回 1st	6回目 6th	30回目 30th
20	N {kgf}	15.7 {1.6}			0.6 {0.6}		
30	N {kgf}	23.6 {2.4}			1.0 {0.1}		
40	N {kgf}	31.5 {3.2}			1.4 {0.14}		
50	N {kgf}	39.3 {4.0}			1.8 {0.18}		
60	N {kgf}	47.2 {4.8}			2.2 {0.22}		

{ } :参考単位 Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE:		
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION		
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
REV.	DESCRIPTION	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER
		PS	000	GENERAL
DOCUMENT NUMBER 2039550000				SHEET 8 OF 14

【7. リフロー条件 REFLOW CONDITION】



温度条件グラフ
(温度は基板パターン面)
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

本リフロー条件に関しては、温度プロファイル、半田ペースト、大気、N2リフロー、基板などにより条件が異なりますので事前に実装評価(リフロー評価)を必ず実施願います。実装条件によっては、製品性能に影響を及ぼす場合があります。Please check the surface-mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand, because they may be different by the temperature profile, the solder paste, the atmosphere (Air or Nitrogen) or the type of the boards. The different conditions may have an influence on the product's performance.

- ・ 推奨ランド寸法 Recommended Pattern dimension:
SDをご参照下さい。
Refer to the Sales Drawing.
- ・ 推奨メタルマスク厚さ Recommended Thickness of metal mask
t = 0.1mm
- ・ 推奨メタルマスク開口率 Recommended Open aperture ratio of metal mask
100% (大気リフロー時 for atmosphere)

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 9 OF 14

【8. その他注意事項 OTHERS】

・外観について Appearance

1. 本製品の樹脂部に黒点、多少の傷、微小な気泡等が生じることがありますが、性能上問題ありません。{また、本製品のモールド材料はLCPを使用しているため、ウェルドラインが目立つ場合がありますが、製品性能には影響ないものです。}
Although this product may have a small black dot, a minimal air bubble or a scratch on the housing, it doesn't impact the product's performance. {Also, although weld line may stand out due to LCP used to mold material of this product, it doesn't impact the product's performance.}
2. 成形品の色相に多少の違いを生じる場合がありますが、製品性能には影響ありません。
Although there may be slight differences in the housing color tone, it doesn't impact the product's performance.
3. 本製品は、補強金具に錫系のめっきを施しておりますので、製造工程にて圧痕が付いてしまいますが、製品性能には影響ありません。
As this product utilizes lead-free Tin plating at fitting nail, impression will be attached in the manufacturing process, but it doesn't impact the product's performance.

・実装について Mount

4. 本リフロー条件に関しては、実装条件(大気/N2 リフロー、温度プロファイル、半田ペースト、メタルマスク板厚・開口率、基板パターンレイアウト、実装基板種別などの種々の要素)により条件が異なりますので、必ずご使用前に、顧客様のご使用環境で事前に実装評価(リフロー評価)を実施願います。実装条件によっては、接点部への半田上がりやフラックス上りが発生するなど製品性能に影響を及ぼす場合があります。
Please make sure to do test run under the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices before use because reflow condition may change due to the local condition (Air / N2 reflow / temperature profile / solder paste, metal mask thickness / aperture rate / pattern layout of PWB / types of PWB / and other factors). Depending on the mounting condition, product's performance might be influenced by occurrence of solder-wicking or flux wicking at contact area.
5. 本製品の一般性能確認はリジッド基板にて実施しております。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。
The product performance was tested using rigid PWB. In case the product needs to be mounted onto FPC, please conduct a reflow test on the FPC before use.
6. フレキシブル基板に実装する場合は、基板の変形を防止するため、補強板をご使用願います。
In case of mounting the connector onto FPC, add a stiffener on the FPC in order to prevent the deformation.
7. 本コネクタを搭載する基板(PWB/FPC)において、過度な温度上昇を避ける為、適切なパターンデザインを行ってください。
Please design appropriate pattern on boards (PWB / FPC) for this connector to avoid excess temperature rise.
8. 弊社の推奨基板パターン寸法を変更して設計を行なう際は、致命的な不良の原因にもなりますので、あらかじめご相談ください。
In case of designing with changing our recommended board pattern size, please consult the contact person in advance because it may cause a fatal defect.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
	REV.				DESCRIPTION
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 10 OF 14
EN-127(2015-12)					

9. 実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mm として下さい。
The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the PWB. Warpage of the PWB should be 0.02mm at maximum at center of the connector based on the both sides of connector.
10. 本製品は大気リフローでの実装を想定しています。N2 リフローで実装した場合、リフロー後、半田上がりを生じる恐れがあります。N2 リフローでの実装をお考えの場合、別途評価が必要になります。
This product is designed to be mounted by air reflow. So, if this product is mounted by N2 reflow, solder wicking may caused after reflow. Therefore if it is plan to adopt N2 reflow for this connector, an evaluation is needed separately.
11. 弊社評価では本仕様書記載の推奨条件に基づき基板をねじ留めした状態で評価を実施しています。はんだペーストは無鉛はんだ(Sn-3Ag-0.5Cu)を使用しています。
Our evaluation is conducted based on Molex-recommended condition that PWB was fixed by screw specified in this product specification. Lead free solder(Sn-3Ag-0.5Cu) was used as the soldering paste.
12. 本製品の平坦度については、実装前での保証のみであり、実装中および実装後での平坦度については、保証の限りではありません。
Only coplanarity before reflow is guaranteed. Coplanarity in and after reflow is not guaranteed.
13. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタの基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行って下さい。
If you leave any soldering area on this product open, it could occur terminal disengagement, short circuit between pins, terminal buckling or connector disengagement from the PWB. Therefore, please solder all of the soldering tails and fitting nails on the PWB.
14. 端子コンタクト部以外の場所へフラックス上りが発生することがありますが、製品性能には影響ありません。
Flux wicking could be occurred on the areas except for the terminal contacts. However it does not impact on the product's performance.
15. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認下さい。
If accidental contact is added onto connectors in the reflow machine, connectors could be deformed or damaged. Therefore review the reflow machine before use of the connectors.
16. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。
Although some discoloration could be seen on the soldering tail after reflow, it does not impact on the product's performance.

・製品の仕様について Product specification

17. 本製品をご使用時には、1PIN 当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けて下さい。
When using this product, ensure that the specification for rated current per a circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION				
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 11 OF 14
EN-127(2015-12)					

18. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けて下さい。接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。
Do not use the connector in a condition where the mating area (contact area) are constantly moved due to sympathetic vibration of wires and PWB or constant movement of devices. It may cause contact failure due to the worn out. Therefore fix wires and PWB on the chassis to reduce sympathetic vibration.
19. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあげた筐体構造にして下さい。
Keep enough clearance between connector and chassis of your application in order to avoid pressure on the connector.
20. 本製品を結露・水濡れが発生する環境でのご使用の場合は、適切な防滴処置をお願い致します。結露・水濡れにより、回路間で絶縁不良を起こす可能性が御座います。
When using this product in an environment where dew condensation and water wetting occur, apply an appropriate drip-proof treatment. Dew condensation and water wetting could cause insulation failure between the circuits.
21. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
Avoid using a connector alone to mechanically support the PWB. Adopt separate fixture to support PWB besides the connector in the chassis.
22. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られていません。スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないで下さい。
Do not mate and un-mate connectors while those are energized since this connector is not designed to allow it. It may cause danger due to sparks and functional failure of the product.
23. 本製品はフローティングコネクタですので、コネクタの動きを妨げないよう電線に適度な緩みを持たせてください。
Since this connector is a floating-type connector, keep enough length and flexure of the wire in order to avoid blocking the connector's movement.
24. 本製品及び加工工程品(仕掛品)や加工品(ハーネス品)の梱包及び輸送・保管時において、コネクタ間での絡みや衝撃、積み重ね等による負荷が掛からないようにして下さい。変形・破損等による性能不良の原因となります。
At packaging, transportation and storing, avoid applying loads to connectors by handling, interference of connectors or piling-up packages. It could cause functional defect such as connector deformation or breakage.
25. 推奨保管条件での保管をお願い致します。もし、梱包品の推奨保管条件を超えてしまった場合は外観、半田付け性を確認の上ご使用ください。
Store the products under recommended storage condition. If the recommended storage conditions of the packaging is exceeded, check the appearance of the products and solder-wettability before use.
26. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。
Do not stack PWB directly after mounting the connector on it.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 12 OF 14
EN-127(2015-12)					

27. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないで下さい。
Do not wash connector because it may impact the product's function.
28. 本製品は、補強金具に錫系のめっきを施しておりますので、ウイスキーが発生する可能性がございます。その為、ウイスキー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上ご使用をお願いします。
This product utilizes lead-free Tin plating at fitting nail. Any product with lead-free Tin plating is susceptible to Tin whisker. Molex provides no assurances against the growth of Tin whisker even under normal operating conditions. Customers assume all responsibility for any product failures due solely to the growth of Tin whiskers.

・製品操作について Product operation

29. 基板実装前後に端子、補強金具に触らないでください。
Do not touch the terminals and fitting nails of connectors before or after mounting onto the PWB.
30. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向へフローティング範囲を超えての負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。Avoid move or assembly of connector which could apply loads over a floating range to the direction of the connector pitch, span or rotation. It may damage the connector and crack the soldering.
31. 嵌合の際、嵌合が不十分にならないようにご注意ください。また、セットへの組み込み後も、振動、衝撃等で嵌合の浮きが発生しないような状態にて使用してください。
Ensure to mate connectors fully. Also mount and assemble the connector in your application unit with disengagement proof to avoid connector disengagement due to vibration or shocks.

・リペアについて Repair

32. 実装後において半田こてによる手修正を行う際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行って下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, follow the soldering conditions shown in the product specification. If the conditions in the product specification are not followed, it may cause the terminal disengagement, contact gap change, housing deformation, housing melting, and connector damage.
33. 半田こてによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないで下さい。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合があります。
When conducting manual repairs using a soldering iron, do not use excess solder and flux than needed. It may cause solder wicking and flux wicking issues, and also eventually cause a contact defect and functional issues.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
A	SEE SHEET 1 OF 14	0.4MM PITCH FLOATING BB CONN PRODUCT SPECIFICATION			
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
REV.	DESCRIPTION				
DOCUMENT NUMBER 2039550000		DOC. TYPE PS	DOC. PART 000	CUSTOMER GENERAL	SHEET 13 OF 14
EN-127(2015-12)					

